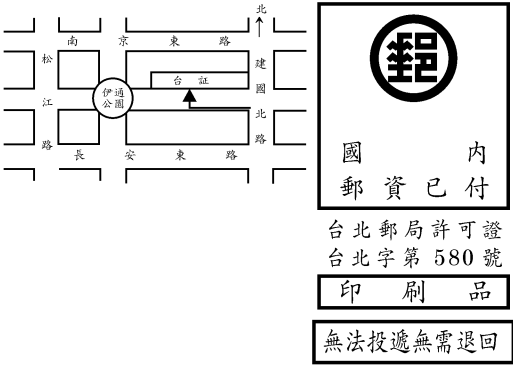


10489
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
台証金融大樓(由92巷進入)
精材科技股份有限公司服務代理人
台証綜合證券股份有限公司服務代理部
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
台証證券網址：www.tsc.com.tw
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6309)
語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號:210
證券代號:3374

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕 9



股東 台啓

精材科技股份有限公司九十七年股東常會議事錄

時 間：中華民國九十七年六月十二日下午一時
地 點：中壢市中壢工業區吉林路二十三號地下一樓（本公司會議室）
本公司已發行總股數：215,739,118股
出席股東及代理人所持股數：177,729,080股
出席股數占全部已發行股數：82.38 %

主 席：蔣尚義 董事長 記 錄：田正人
議 程：
壹、大會報告出席股數已逾法定數，主席依法宣佈開會。
貳、主席致辭（略）
參、報告事項
一、民國九十六年度營業報告（詳附件一）。
二、監察人查核報告（詳附件二）。
肆、承認及討論事項
一、承認民國九十六年度之營業報告書及財務報表。（董事會提）
說明：（一）本公司九十六年度財務報表，包括：資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，業經勤業眾信會計師事務所黃鴻文及黃樹傑會計師查核簽證完竣。
（二）民國九十六年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件一及附件三～七。
（三）敬請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
二、核准民國九十六年度盈餘分派之議案。（董事會提）
說明：（一）本次盈餘分派案，係分配民國九十六年度可分配盈餘，普通股現金股利每股配發新台幣0.2元，普通股股票股利每仟股無償配發10股。
（二）民國九十六年度盈餘分派表，請參閱附件八。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
三、核准民國九十六年度盈餘轉增資（股利及員工紅利）之議案。（董事會提）
說明：（一）為購置機器設備、擴充產能，擬自民國九十六年度當年度可分配盈餘中提撥股票股利新台幣21,573,910元及員工紅利新台幣33,829,250元轉作資本。
（二）以上共擬增資新台幣55,403,160元，計發行新股5,540,316股，每股新台幣壹拾元，均為普通股。新股之權利義務與原發行股份相同，俟呈奉主管機關核准後由董事會或其授權之人另訂配股基準日。
（三）股票股利分配方式為按配股基準日股東名簿所載股東持有股數，每仟股無償配發壹拾股，配發不足壹股之畸零股，由股東自配股基準日起五日內，辦理自行合併湊成壹股之登記，其併湊不足部份，按面額折付現金計算至元為止，不足壹股之畸零股由董事會授權董事長洽特定人認購之。
（四）本次增資後，本公司實收資本額將為新台幣2,212,794,340元整。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
四、核准本公司民國九十六年度現金增資購置機器設備之投資計劃，選擇五年免徵營利事業所得稅之租稅優惠之議案。（董事會提）
說明：（一）依「促進產業升級條例」之規定，公司符合新興重要策略性產業適用範圍者，於其股東開始繳納股票價款之當日起兩年內得經股東會同意選擇適用免徵公司營利事業所得稅並放棄股東投資抵減所得稅，擇定後不得變更。

（二）本公司民國九十六年度現金增資用以購置先進積體電路封裝技術所需之機器設備等之投資計畫，業經主管機關認定符合新興重要策略性產業，依規定得享租稅優惠。考量本公司營運狀況及未來發展，擬選擇適用「五年免徵營利事業所得稅」之租稅優惠，並於本年度之股東常會中提案擇定之。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
五、核准修訂「取得或處分資產處理程序」。（董事會提）
說明：（一）為因應本公司營運規模及組織結構之變化，茲參考業界慣例及公司實際運作狀況與需求，修改本公司「取得或處分資產處理程序」中有關衍生性商品交易之部分規定，包括避險策略、核決權限、風險管理措施等。
（二）本次「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表，請參閱附件九。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
伍、選舉事項
補選董事一席，任期至民國九十九年三月四日止。（董事會提）
說明：（一）因董事英屬蓋曼群島商豪威國際控股公司於民國九十七年六月十一日辭去董事職務，故補選一席董事。
（二）新任董事之任期以補足原董事之任期為限，自民國九十七年六月十二日起至民國九十九年三月四日止。
（三）敬請選舉。

選舉結果：

戶號	職稱	股東戶名/姓名	代表人	當選權數
97597	董事	台灣豪威投資控股股份有限公司	何新平	161,038,788

陸、討論事項
核准解除新任董事就業禁止之限制。（董事會提）
說明：（一）依據公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
（二）提請股東會核准自即日起解除其就業禁止之限制。
（三）董事擔任其他公司之職務請參附件十。
（四）提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
柒、臨時動議
（股東提問暨公司之答覆略）

經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出，主席宣佈議畢散會。

<附件一> 精材科技股份有限公司

民國九十 查核報告書

本公司民國九十六年的營運表現穩定成長，營收與獲利均締造新紀錄。除持續強化在晶圓級封裝的各項服務外，本公司更致力於提升產品品質，製造能力及研發技術。有鑒於感測器相關產品需求持續成長以及晶粒尺寸不斷縮小的技術趨勢，本公司新製程適時導入量產，顯著降低客戶之製造成本，因此得以鞏固本公司在全球晶圓級封裝製程的技術領先優勢。

經營實績

在全體同仁全力以赴、孜孜不息的努力下，本公司民國九十六年全年營收為新台幣3,387,131千元，較前一年營收2,137,064千元成長58%；稅後淨利為新台幣501,174千元，較前一年稅後淨利305,714千元成長64%；每股盈餘為新台幣2.33元。

企業發展

為了公司的長期發展與成長，本公司於民國九十六年一月五日策略性引進台灣積體電路製造股份有限公司投資本公司。台積公司已與本公司合作開發多項創新技術，由台積公司提供前段矽元件製程，本公司提供後段製程封裝服務，有效強化技術開發及製程整合服務。新技術預計將可應用於先進光學感測器、高功率元件與微機電，對於開發新的商機將有所裨益。

為進一步因應客戶之需求，本公司於中壢新設二廠以提供八吋晶圓級封裝服務，並於民國九十六年第二季如期順利量產，以極佳的良率加入生產行列。此外，本公司並於新竹科學工業園區新設三廠，與台積公司合作並共同開發十二吋晶圓級封裝技術，目前已進入驗證階段，預計將於民國九十七年第二季開始導入量產。

技術與創新

持續不斷地精進研究開發技術，是提升企業競爭優勢的重要關鍵。在過去一年中，本公司完成超薄型晶圓級封裝（XinPac™）製程的技術開發與量產，得以提供客戶高品質、高良率及更小封裝係數（Form Factor）的封裝製程。

此外，為因應感測器前段技術之提昇及元件設計之需求，本公司於民國九十六年成功地開發了薄金屬（Thin Metal）製程、先進設計規則及雙層線路（Double Layer Metallization）製程等技術。藉由技術多樣化的發展，不但更能因應客戶的各種需求進而強化其產品競爭力，對新商機的發展，亦多所助益。

除了提升在現有影像感測元件市場之競爭力外，本公司亦積極尋求新的市場及技術應用，以避免單一產業景氣循環所造成的營運風險。因此，本公司在民國九十六年開始進行新技術的研發。開發中的矽孔封裝（Through Silicon Via）服務及晶圓封裝（Wafer Level Chip Scale Package）方案，預計於民國九十七年下半年將可陸續導入量產，相關製程可廣泛應用於光學封裝、無線元件產品封裝等領域。未來本公司也將持續致力於延伸開拓更多新核心技術及應用，並不斷探索各種策略合作的可能。

前景與展望

展望民國九十七年，影像感測器的產品將有可能維持10%以上的成長。高像素（高於兩百萬畫素）影像感測器的比重將持續增加。除手機市場外，影像感測器之應用亦將逐步推廣至手提電腦、安全維護、車用監控及醫療用途等。由於晶粒不斷縮小之趨勢，晶圓級封裝技術更能提供高品質、低成本的封裝服務。

未來，本公司將加速研發符合未來市場導向的解決方案，落實製造服務本業提供客戶最佳服務，拓展晶圓級相關製程技術的應用，以成為穩定成長、客戶可充分倚賴的全球晶圓級封裝服務領導廠商。

負責人：蔣尚義 經理人：林俊吉 會計主管：林恕敏

<附件二> 監察人查核報告書

董事會造送本公司民國九十六年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人等查核，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

精材科技股份有限公司

監察人 盧桐秋

監察人 呂照斌

中 華 民 國 九 十 七 年 三 月 十 四 日

<附件三> 會計師查核報告

精材科技股份有限公司 公鑒：

精材科技股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達精材科技股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，精材科技股份有限公司自民國九十五年一月一日起，採用新發布之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」，以及其他相關公報配合新修訂之條文。

精材科技股份有限公司民國九十六年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

勤業眾信會計師事務所

會計師 黃 鴻 文 會計師 黃 樹 傑

黃鴻文 黃樹傑

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號 台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 九 十 七 年 一 月 七 日

精材科技股份有限公司	
盈餘分派表	
民國九十六年十二月三十一日	
民國九十六年度純益	NT\$501,174,040
減：	
- 提撥百分之十法定盈餘公積	50,117,404
民國九十六年度可分配盈餘	451,056,636
加：	
- 以前年度未分配盈餘	185,766,809
截至民國九十六年底可分配盈餘	636,823,445
分派項目：	
- 員工紅利（以現金發放）	33,829,245
- 員工紅利（股票依面額發放）	33,829,250
- 董監事酬勞	9,021,132
- 普通股現金股利	43,147,823
（每股新台幣0.20元）	
- 普通股股票股利	21,573,910
（依面額分派每股新台幣0.10元）	
分派項目合計	141,401,380
期末未分配盈餘	NT\$495,422,065

註：1.擬配發員工股票股利股數3,382,925股，其占盈餘轉增資之比例為61.06%。
2.考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘為1.98元。
3.本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：本公司須公開民國九十六年度財務預測資訊，故不適用。

負責人：蔣尚義 經理人：林俊吉 會計主管：林恕敏

